



Initial Product/Process Change Notification

Document #:IPCN22649X1

Issue Date:20 Feb 2020

Title of Change:	Update to IPCN22649X - Cancellation of previously announced PQFN56 Wired Etched (SN 500939) to Stamped Leadframe (SN 501354) Qualification and changed plating in DAP and Leadpost.	
Proposed First Ship date:	20 Feb 2020 or earlier if approved by customer.	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Edgar.Ares@onsemi.com>	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	None	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Cebu, Philippines	None	
Description and Purpose:		
This Update is to formally notify our customers that the intended change describe and previously communicated in IPCN22649X will be CANCELLED and will not be implemented.		
IPCN22649X previously announced PQFN56 Wired Etched (SN 500939) to Stamped Leadframe (SN 501354) Qualification and changed plating in DAP and Leadpost.		
Qualification Plan:		
N/A		
List of Affected Parts:		
<i>Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the PCN Customized Portal.</i>		
Part Number	Qualification Vehicle	
FDMS86101-F032	FDMS039N08B-SN00355	
FDMS86200-F032	FDMS039N08B-SN00355	
FDMS6681Z	FDMS039N08B	



FDMS86581	FDMS039N08B
FDMS86101	FDMS039N08B
FDMS86101A	FDMS039N08B
FDMS8670S	FDMS039N08B
FDMS86322	FDMS039N08B
FDMS5352	FDMS039N08B
FDMS3500	FDMS039N08B
FDMS3662	FDMS039N08B
FDMS030N06B	FDMS039N08B
FDMS037N08B	FDMS039N08B
FDMS015N04B	FDMS039N08B
FDMS039N08B	FDMS039N08B
FDMS4D4N08C	FDMS039N08B
FDMS86300	FDMS039N08B
FDMS86200	FDMS039N08B
FDMS86263P	FDMS039N08B
FDMS86500L	FDMS039N08B
FDMS86540	FDMS039N08B
FDMS86201	FDMS039N08B
FDMS86163P	FDMS039N08B
FDMS86103L	FDMS039N08B
FDMS86310	FDMS039N08B
FDMS86250	FDMS039N08B

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22649X1

発行日: 20 Feb 2020

変更件名:	IPCN22649X の更新 - 以前お知らせした、PQFN56 ワイヤーエッチング (SN 500939) からスタンプリードフレーム (SN 501354) への変更認定と DAP およびリードポストにおけるメッキ変更のキャンセル	
初回出荷予定日:	20 Feb 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Edgar.Ares@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。	
変更部品の識別:	なし	
変更カテゴリ:	アセンブリの変更	
変更サブカテゴリ:	材料の変更	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Cebu, Philippines	なし	
説明および目的:	この更新は、以前に IPCN22649X でお知らせしました、予定の変更内容がキャンセルされ、実施されないことをお客様に正式に通知するためのものです。 IPCN22649X では、以前に、PQFN56 ワイヤーエッチング (SN 500939) からスタンプリードフレーム (SN 501354) への変更認定と、DAP およびリードポストにおけるメッキを変更することをお知らせしました。	
認定計画:	N/A	
影響を受ける部品の一覧:	注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。	
	部品番号	認定試験用ピークル
	FDMS86101-F032	FDMS039N08B-SN00355
	FDMS86200-F032	FDMS039N08B-SN00355
	FDMS6681Z	FDMS039N08B
	FDMS86581	FDMS039N08B
	FDMS86101	FDMS039N08B



FDMS86101A	FDMS039N08B
FDMS8670S	FDMS039N08B
FDMS86322	FDMS039N08B
FDMS5352	FDMS039N08B
FDMS3500	FDMS039N08B
FDMS3662	FDMS039N08B
FDMS030N06B	FDMS039N08B
FDMS037N08B	FDMS039N08B
FDMS015N04B	FDMS039N08B
FDMS039N08B	FDMS039N08B
FDMS4D4N08C	FDMS039N08B
FDMS86300	FDMS039N08B
FDMS86200	FDMS039N08B
FDMS86263P	FDMS039N08B
FDMS86500L	FDMS039N08B
FDMS86540	FDMS039N08B
FDMS86201	FDMS039N08B
FDMS86163P	FDMS039N08B
FDMS86103L	FDMS039N08B
FDMS86310	FDMS039N08B
FDMS86250	FDMS039N08B



Appendix A: Changed Products

DIKG : DIGI-KEY

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
FDMS86250		FDMS039N08B		
FDMS86310		FDMS039N08B		
FDMS86103L		FDMS039N08B		
FDMS86163P		FDMS039N08B		
FDMS86201		FDMS039N08B		
FDMS86540		FDMS039N08B		
FDMS86500L		FDMS039N08B		
FDMS86263P		FDMS039N08B		
FDMS86200		FDMS039N08B		
FDMS86300		FDMS039N08B		
FDMS039N08B		FDMS039N08B		
FDMS015N04B		FDMS039N08B		
FDMS037N08B		FDMS039N08B		
FDMS030N06B		FDMS039N08B		
FDMS3662		FDMS039N08B		
FDMS3500		FDMS039N08B		
FDMS5352		FDMS039N08B		
FDMS86322		FDMS039N08B		
FDMS8670S		FDMS039N08B		
FDMS86101A		FDMS039N08B		
FDMS86101		FDMS039N08B		
FDMS6681Z		FDMS039N08B		